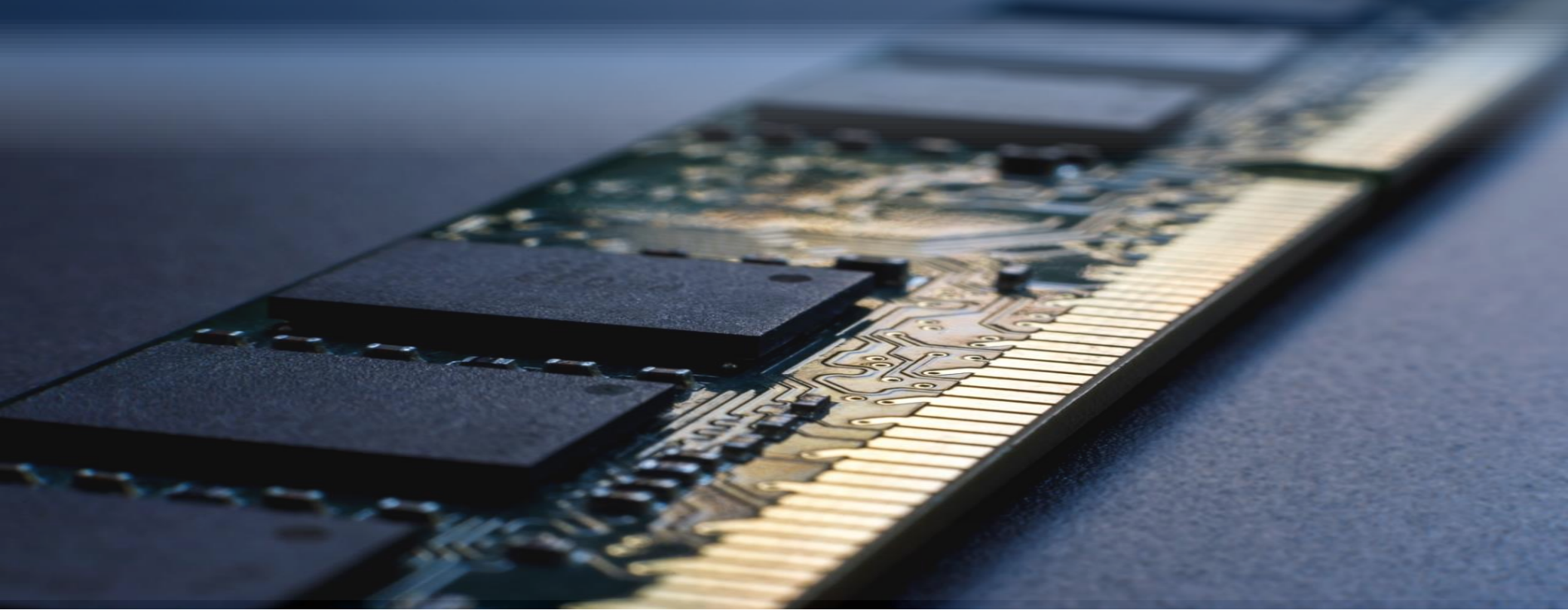




티엘비 2025년 NDR자료

2025.02.24

본 자료는 투자자의 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 작성된 자료입니다.

자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.
(과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 회사가 발생하는 증권의 모집 또는 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며,
문서의 어떠한 내용도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.

티엘비의 미션



인쇄회로기판으로 4차산업을 선도하여,
그 가치를 사원·고객·사회와 공유합니다.

티엘비 성장현황 및 미래전략

2011~2018

2019~2020

2021~2022

2023~

티엘비 1.0

티엘비 2.0

PCB 벤처기업
중견 기업 선정

사업 고도화
IPO 상장

해외투자

사업확장 및
해외 사업 본격화

- 11년 06월 (주)티엘비 창립
11월 연구소 설립
- 13년 04월 TS 인증 완료
05월 ISO 인증 완료
07월 TLB UL 승인
- 15년 05월 한국중견기업 연합회 정회원
- 16년 05월 중소기업청 표창장 수상
12월 1억불 수출탑 수상
- 17년 삼성 Best Partner 선정
- 18년 삼성 Best Partner 선정
05월 World Class 300 선정
10월 환경안전 경영대상 수상

- 19년 삼성 Best Partner 선정
04월 하이닉스 동반성장 협의회 가입
10월 안전경영대상 최우수상 수상
- 20년 12월 티엘비 코스닥 상장
하이닉스 동반성장 부문 대상

- 21년 베트남 해외 법인 설립
선도형 디지털 클러스터 선정
혁신기업 국가대표 1000 선정
- 22년 베트남 법인 건축공사 착공
하이닉스 Best Supplier 선정
글로벌 스탠다드 경영대상

- 23년 베트남 공장 후공정 설립
은탑산업 훈장
코스닥 우량기업 선정
- 24년 안산 사무동 (8,000m²)
완공 및 입주 완료

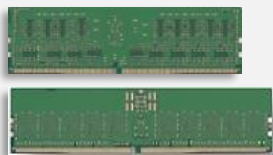
“티엘비 3.0”

지속적인 차세대 제품 개발·선점으로 시장 경쟁력 강화

TLB 핵심 제품

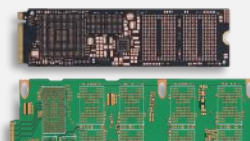
Memory Module

R-DIMM
DDR5



e-SSD Module

SSD
EDSFF



차세대 신제품

CXL

(Compute Express Link)

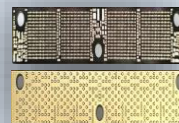
지정된 CPU에 메모리 제공할 뿐만 아니라,
지정되지 않은 CPU에 메모리 확장한 제품



SOCAMM

(System On Chip with Advanced Memory Module)

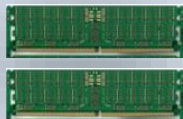
디지털, 아날로그, 혼합 신호 회로를 하나의 칩에
집적해 소형 고성능 저전력을 구현한 제품



MR-DIMM

(Multiplexed Rank Dual Inline Memory Module)

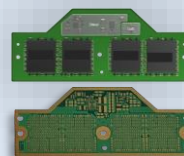
여러 개 D램이 결합된 모듈 제품
랭크(Rank) 2개 동시 작동으로 속도 향상



LPCAMM

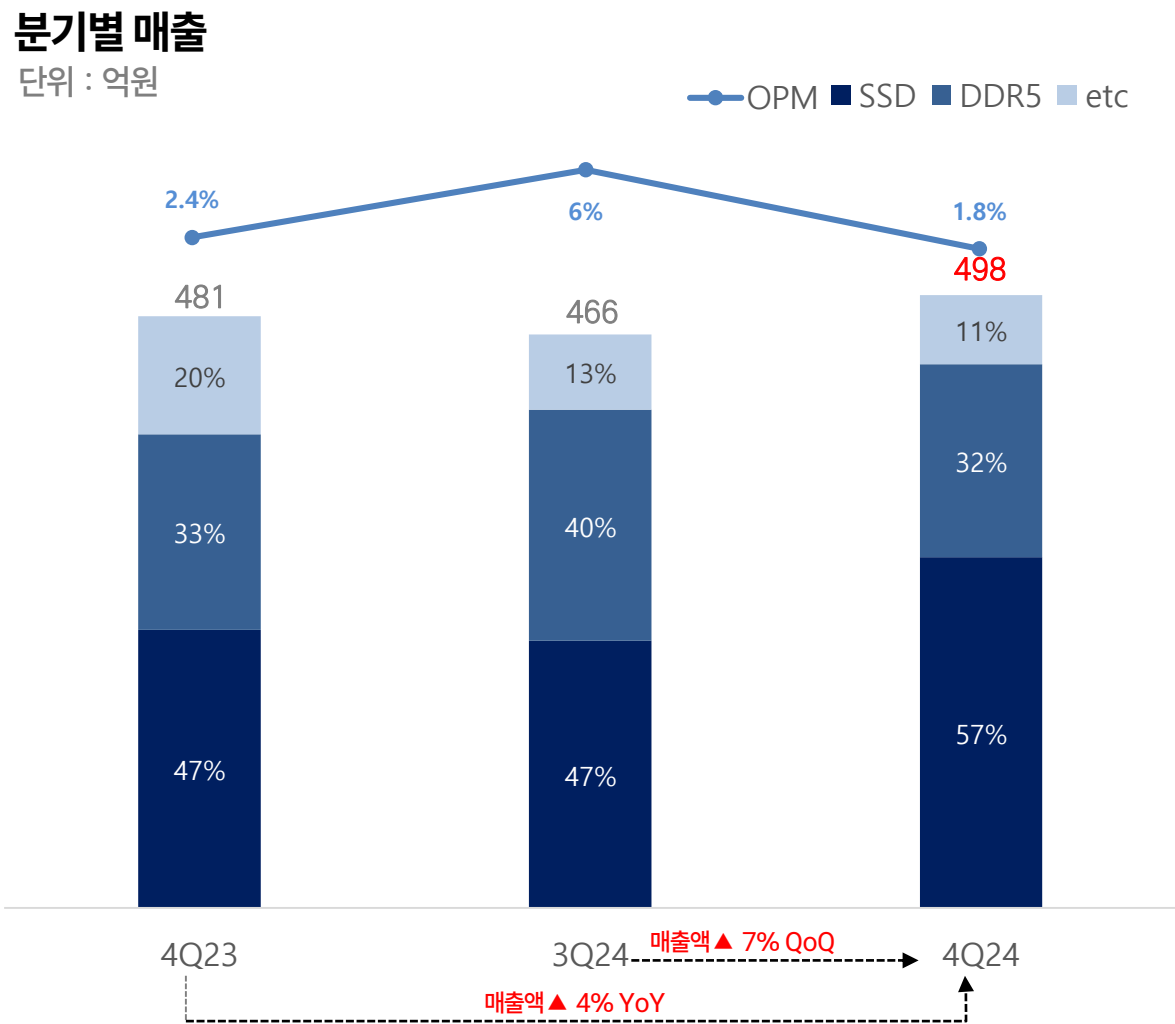
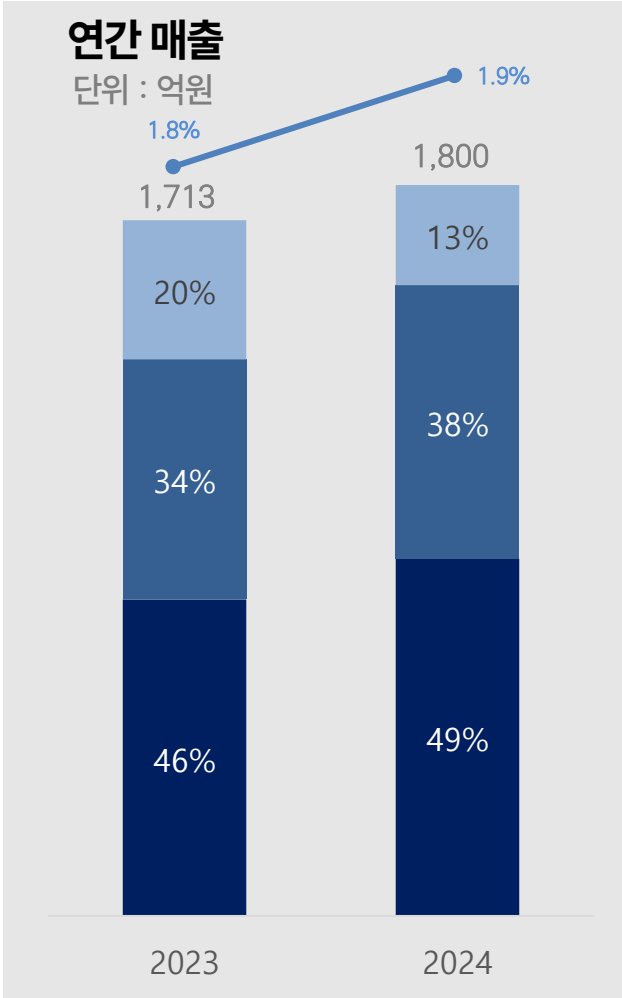
(Low Power Compression Attached Memory Module)

LPDDR 기반의 새로운 폼팩터로
전력을 최소화하여 열발생을 줄이는데 주로 사용



2024 경영성과 _ 분기별 실적

2024년 총 매출액은 1,800억원으로 전년 대비 ▲ 4% 증가
4Q 매출액 498억원(▲ 7% QoQ), 매출 비중은 SSD 57%, DDR5 32%



Core Business Partners





경기도 안산시 단원구 신원로 305(목내동) 16BL 17LT

IR 관련 문의 : purple@tlbpcb.com

www.tlbpcb.com